

トレックス・セミコンダクター株式会社  
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XCL101xxxxBR-G  
標準重量: 20 mg

部位	名称	重量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CASナンバー
コイル	コア(フェライト)	7.706	酸化鉄	385300	1309-37-1
		2.371	酸化亜鉛	118600	1314-13-2
		1.304	酸化ニッケル	65200	1313-99-1
		0.474	酸化銅	23700	1317-38-0
	ベース基板	0.105	ビスマレイド・トリアジン樹脂/エポキシ樹脂	5300	-
		0.068	無機フィラー	3400	-
		0.203	ガラスクロス	10100	65997-17-3
	中間保護膜樹脂A	0.054	エポキシ樹脂	2700	25068-38-6
		0.121	シリカ	6000	-
	保護膜樹脂B (トップコーティング)	0.043	エポキシ樹脂	2200	25068-38-6
		0.096	シリカ	4800	-
	接着樹脂	0.290	エポキシ樹脂	14500	25068-38-6
		0.646	シリカ	32300	-
導体(巻線部)	2.340	銅	117000	7440-50-8	
端子メッキ	0.043	ニッケル	2200	7440-02-0	
	0.118	錫	5900	7440-31-5	
接着剤	0.012	エポキシ樹脂	600	-	
	0.007	シリカ	400	14808-60-7	
IC	シリコンチップ	0.340	シリコン	17000	7440-21-3
		-	砒素	<1	7440-38-2
	リードハット	1.255	ニッケル	62800	7440-02-0
		0.116	銀	5800	7440-22-4
		0.022	金	1100	7440-57-5
	ダイアタッチ	0.024	エポキシ樹脂	1200	-
		0.018	シリカ	900	60676-86-0
	ボンディングワイヤ	0.071	金	3500	7440-57-5
	封止樹脂	1.670	溶融シリカ	83500	60676-86-0
		0.170	エポキシ樹脂	8500	-
		0.159	フェノール樹脂	8000	-
		0.155	金属水酸化物	7700	-

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。  
 ※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。  
 ※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。